

JOINT3 개요

이름	JOINT3 (JOINT: Jisso Open Innovation Network of Tops)
목표	참여 기업과의 공동 개발을 통해 패널 레벨 유기 인터포저에 최적화된 재료, 장비, 설계 도구 개발 가속화
참여 기업(알파벳순으로 나열)	<p>27 개 기업(2025 년 9 월 3 일 기준)</p> <p>레조낙(Resonac Corporation), 에이지씨(AGC Inc.), 어플라이드 머티리얼즈(Applied Materials, Inc.),          에이에스엠피티(ASMPT Singapore Pte. Ltd.), 브루어 사이언스(Brewer Science, Inc.), 캐논(Canon Inc.),          코멧 익슬론(Comet Yxlon GmbH), 에바라(EBARA Corporation), 후루카와 일렉트릭(Furukawa Electric Co., Ltd.),          히타치 하이테크(Hitachi High-Tech Corporation), 제이엑스 어드밴스드 메탈스(JX Advanced Metals Corporation),          카오(Kao Corporation), 램리서치 잘츠부르크(Lam Research Salzburg GmbH),          린텍(LINTEC Corporation), 엠이씨(MEC COMPANY LTD.),          미쓰토요(Mitutoyo Corporation),          나믹스(NAMICS Corporation), 닛코 머티리얼스(Nikko-Materials Co., Ltd.),          오쿠노 케미칼 인더스트리(OKUNO CHEMICAL INDUSTRIES CO., LTD.),          시놉시스(Synopsys, Inc.), 도쿄 일렉트론(Tokyo Electron Ltd.), 도쿄 오카 코교(Tokyo Ohka Kogyo Co., Ltd.),          토와(TOWA Corporation), 알박(ULVAC, Inc.), 우시오(Ushio Inc.), 주켄(ZUKEN Inc.), 쓰리엠 컴퍼니(3M Company)</p>

<p>위치</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 첨단 패널 레벨 인터포저 센터 "APLIC"(일본 이바라키현 유키시, 레조낙 시모다테 공장 내)</li> <li>• 패키징 솔루션 센터(일본 가나가와현 가와사키시)</li> </ul>
<p>Activities</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 패널 레벨(515 x 510mm) 시제품 생산 라인을 활용한 유기 인터포저용 재료, 장비, 설계 도구 개발</li> <li>• 재료 및 장비 제조업체들이 공통 시제품을 제작하여 협업에 의한 개발을 추진</li> <li>• JOINT3 를 기술 및 장비 제조업체들이 패널 레벨 유기 인터포저 관련 기술을 고도화하는 테스트베드로 활용</li> </ul>